



Title of Change:	5-inch Production line closure of ON Semiconductor Niigata Co., Ltd. (OSNC)													
Proposed First Ship date:	4 October 2019													
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Tetsuya.Fukushima@onsemi.com>													
Samples:	<i>Samples should be available after completion of qualification.</i> Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.Samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.													
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. IPCNs are typically issued 30 days prior to the issuance of the Final Change Notice (FPCN). An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com>													
Change Part Identification:	Date Code													
Change Category:	☒ Wafer Fab Change ☐ Assembly Change ☐ Test Change ☐ Other _____													
Change Sub-Category(s):	☐ Manufacturing Site Addition ☐ Material Change ☐ Datasheet/Product Doc change ☐ Manufacturing Site Transfer ☐ Product specific change ☐ Shipping/Packaging/Marking ☒ Manufacturing Process Change ☐ Other: _____													
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Niigata, Japan	External Foundry/Subcon Sites: None												
Description and Purpose: 5-inch production line closure due to the supply risk for 5-inch substrates from our wafer manufacturers as well constraints resulting from the aging of 5-inch production equipment. The related products will be transferred to the same site (OSNC) 6-inch production line.														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Change Point</th> <th>Before Change Description</th> <th>After Change Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fab (OSNC)</td> <td>N1 Fab (Minimum rule=0.8um, Class=10)</td> <td>N1 Fab (Minimum rule=0.8um, Class=10) AND N2 Fab (Minimum rule=0.25um, Class=1)</td> </tr> <tr> <td>Equipment</td> <td>5inch equipment</td> <td>6inch equipment (Each function is the same)</td> </tr> <tr> <td>Si Sub material</td> <td>5inch wafer</td> <td>6inch wafer (No change except wafer diameter)</td> </tr> </tbody> </table>			Change Point	Before Change Description	After Change Description	Fab (OSNC)	N1 Fab (Minimum rule=0.8um, Class=10)	N1 Fab (Minimum rule=0.8um, Class=10) AND N2 Fab (Minimum rule=0.25um, Class=1)	Equipment	5inch equipment	6inch equipment (Each function is the same)	Si Sub material	5inch wafer	6inch wafer (No change except wafer diameter)
Change Point	Before Change Description	After Change Description												
Fab (OSNC)	N1 Fab (Minimum rule=0.8um, Class=10)	N1 Fab (Minimum rule=0.8um, Class=10) AND N2 Fab (Minimum rule=0.25um, Class=1)												
Equipment	5inch equipment	6inch equipment (Each function is the same)												
Si Sub material	5inch wafer	6inch wafer (No change except wafer diameter)												

**Qualification Plan:**QV DEVICE NAME LV5115NV-TLM-HPACKAGE SSOP54 (375mil)

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, Vcc max	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc
THB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, bias	1008 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 3 @ 260 °C	-
HBM	JS001	100pF,1.5kohm,+/-1000V	-
CDM	JSTD002	+/-500V	-

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
LV5115NV-TLM-H	LV5115NV-TLM-H

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号: IPCN22135XD

発行日: 9 January 2019

変更件名:	オン・セミコンダクター新潟株式会社 (OSNC) の 5 インチ生産ラインの閉鎖													
初回出荷予定日:	4 October 2019													
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Tetsuya.Fukushima@onsemi.com> にお問い合わせください。													
サンプル:	サンプルの提供は認定完了後に開始されます。 現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、今回の変更の初回通知、初回 PCN または最終 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。													
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。 IPCN は、通常、最終変更通知 (FPCN) の発行の 30 日前に発行されます。 IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。 また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。 この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。 ご不明な点がありましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。													
変更部品の識別:	日付コード													
変更カテゴリ:	☒ ウェハファブの変更 ☐ アセンブリの変更 ☐ 試験の変更 ☐ その他 _____													
変更サブカテゴリ:	☐ 製造拠点の追加 ☐ 製造拠点の移転 ☒ 製造プロセスの変更 ☐ 材料の変更 ☐ 製品仕様の変更 ☐ データシート/製品資料の変更 ☐ 出荷/パッケージング/表記 ☐ その他: _____													
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: ON Niigata, Japan	外部製造工場 / 下請業者拠点: なし												
説明および目的: 5 インチ生産ラインの閉鎖は、ウェハーサプライヤーからの 5 インチウェハーの供給リスクと、5 インチ製造装置の経年劣化によるものです。 関連製品は同じ製造拠点 (OSNC) の 6 インチ生産ラインに移管されます。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #92d050;"> <th style="width: 20%;">変更点</th> <th style="width: 40%;">変更前の表記</th> <th style="width: 40%;">変更後の表記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>製造 (OSNC)</td> <td>N1 製造 (最小ルール=0.8um、クラス=10)</td> <td>N1 製造 (最小ルール=0.8um、クラス=10) および N2 製造 (最小ルール=0.25um、クラス=1)</td> </tr> <tr> <td>装置</td> <td>5 インチ装置</td> <td>6 インチ装置 (それぞれの機能は同じ)</td> </tr> <tr> <td>Si サブマテリアル</td> <td>5 インチ ウェハ</td> <td>6 インチ ウェハ (ウェハ径以外に変更なし)</td> </tr> </tbody> </table>			変更点	変更前の表記	変更後の表記	製造 (OSNC)	N1 製造 (最小ルール=0.8um、クラス=10)	N1 製造 (最小ルール=0.8um、クラス=10) および N2 製造 (最小ルール=0.25um、クラス=1)	装置	5 インチ装置	6 インチ装置 (それぞれの機能は同じ)	Si サブマテリアル	5 インチ ウェハ	6 インチ ウェハ (ウェハ径以外に変更なし)
変更点	変更前の表記	変更後の表記												
製造 (OSNC)	N1 製造 (最小ルール=0.8um、クラス=10)	N1 製造 (最小ルール=0.8um、クラス=10) および N2 製造 (最小ルール=0.25um、クラス=1)												
装置	5 インチ装置	6 インチ装置 (それぞれの機能は同じ)												
Si サブマテリアル	5 インチ ウェハ	6 インチ ウェハ (ウェハ径以外に変更なし)												



認定計画:

QV 素子名 LV5115NV-TLM-Hパッケージ SSOP54 (375mil)

テスト	仕様	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, Vcc max	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc
THB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, bias	1008 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 3 @ 260 °C	-
HBM	JS001	100pF, 1.5kohm, +/-1000V	-
CDM	JSTD002	+/-500V	-

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
LV5115NV-TLM-H	LV5115NV-TLM-H